



華泰電子股份有限公司
a Partner You Can Count On

遇見華泰 | 啟動你的職涯航道

半導體系列講座暨學程說明會

Nov., 2025

Get Started 半導體產業鏈

遠見35



台灣半導體聚落 牽動全球科技業生命線

「如果台灣有一整年無法生產晶片，全球電子業營收將減少近5000億美元，」美國半導體協會今年3月的研究報告，直指台灣半導體產業對世界的影響。

全球依賴台灣不斷加劇的主因，來自2情，以及中美兩大強權的矛盾。前者後者則凸顯地緣政治牽動供應鏈關係，灣，成為討論焦點。

晶圓製造、IC封測市占世界第一，台灣半導體掌握全球科技生命線

2025臺灣半導體產值達5.45兆新台幣
成長15.4% 7nm以下全球先進製程
產能 臺廠占全球產能63%

電子與綠能

瀏覽數：17282次 發布日期：2025/05/07

資策會產業情報研究所（MIC）於5/7-5/9舉辦第38屆MIC FORUM Spring《AI無界AI Boundless》研討會，今日發布半導體產業趨勢預測，並預測2030年臺灣IC製造業者於全球的產能分布。綜覽全球半導體市場發展，HPC、AI、次世代通訊、車用、IoT等五大關鍵應用的長期需求，將持續驅動未來五年全球半導體市場成長，全球半導體市場規模將於2030年突破1兆美元。展望全球半導體市場供需，產業顧問彭茂榮指出，2025年終端產品多具拉貨

業、電
負責生
基礎和
兩大強
好持續

🏠 > 產業 > 半導體 >

不只地緣政治 這2個原因也促使台灣半導體業全球布局

2023.09.10 / 08:00 / 今周刊

導體復甦有正面影

新台幣。其中，先進
運算需求持續高漲、
惟美國政府的關稅政
產值年成長12%，達

讓台灣成世界IC設計重鎮 政院砸120億 推晶創台灣計畫

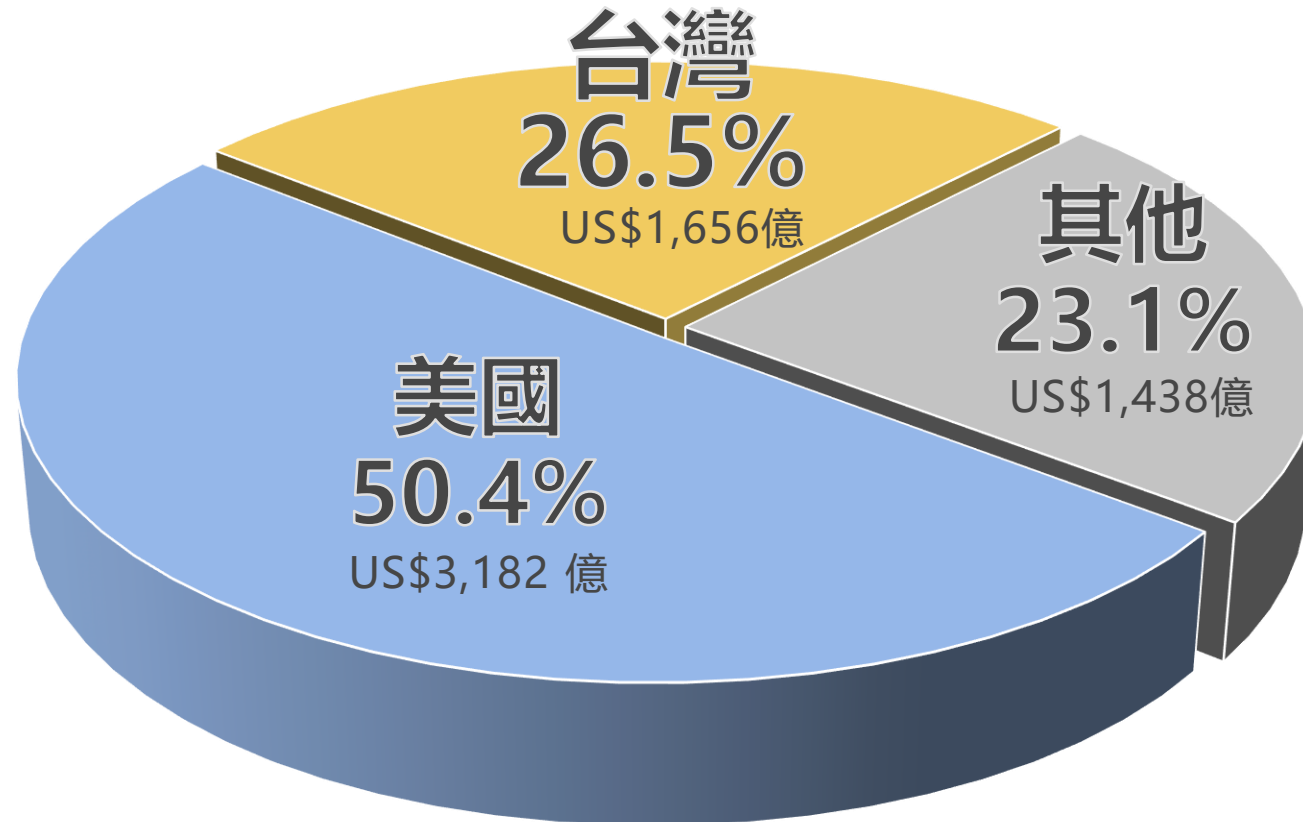
2023/08/16 05:30

2024全球半導體產值 US\$6,276億

資料來源：國家發展委員會

總產值

全球第二

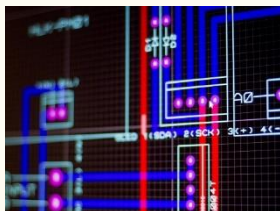
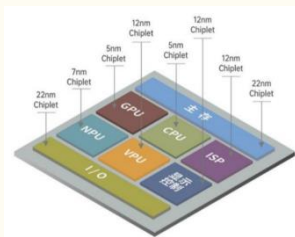


半導體產業鏈：分為IP/IC設計、IC晶圓製造、IC封裝測試、模組組裝、及IC通路

上游

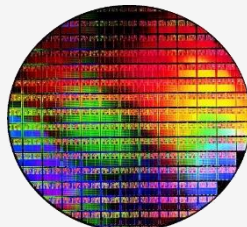
IP/IC
設計代工

IC
設計



中游

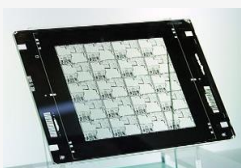
IC/晶圓
製造



生產製程
及
檢測設備

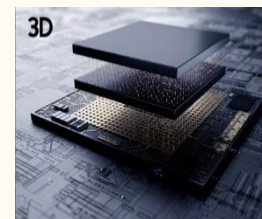
光罩

化學品



下游

IC
封裝測試



IC
模組組裝

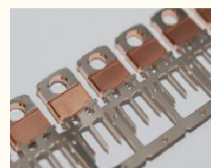
IC
通路



生產製程
及
檢測設備

基板

導線架



半導體產業鏈

上游 IC設計

記憶體IC

晶豪科、鈺創

邏輯IC

聯詠、瑞昱、
義隆、聯陽

微元件IC

威盛、凌陽、
盛群

類比IC

茂達、尼克森、
致新

ASIC

聯發科、群聯

中游 IC設計

晶圓代工

台積電、聯電、力晶、世界先進、穩懋

IC製造設備

漢微科、漢辰、盟立、家登

記憶體製造

南亞科、台灣美光、旺宏、華邦

IC製造材料

台灣光罩、中美矽晶

下游 IC封測

IC封裝

日月光、力成、南茂、

華泰

IC封裝設備

均豪、鈦昇、弘塑

IC封裝材料

長華、景碩、欣興

IC測試設備

致茂、德律

IC測試

京元電、欣銓、矽格

下游 應用

PC/NB

通訊

消費性電子

車用電子

工業

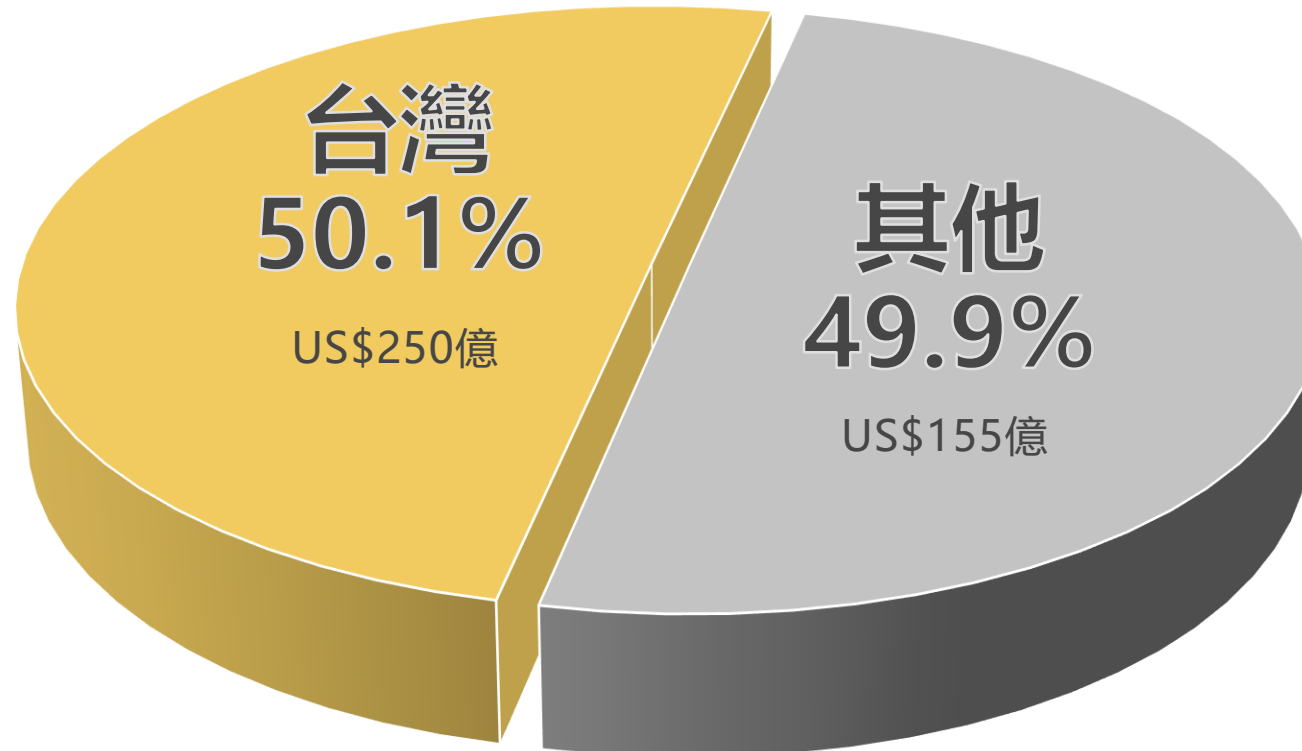
國防

2024全球IC封測業產值 US\$405億

密
Security C

技術
總產值

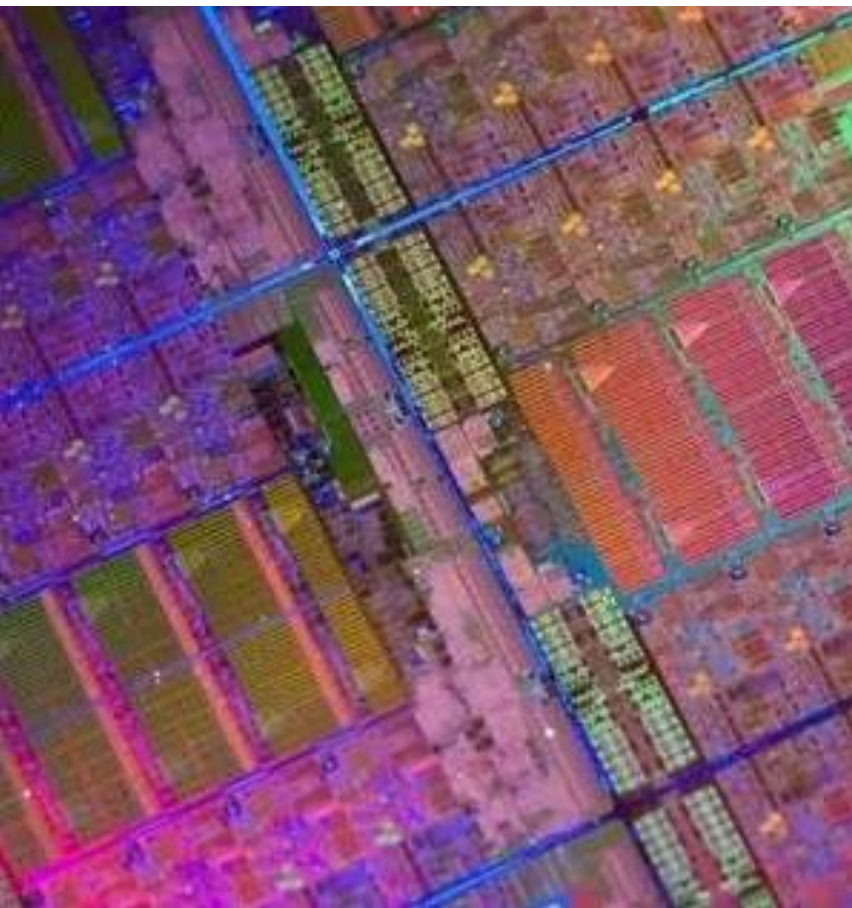
全球第一



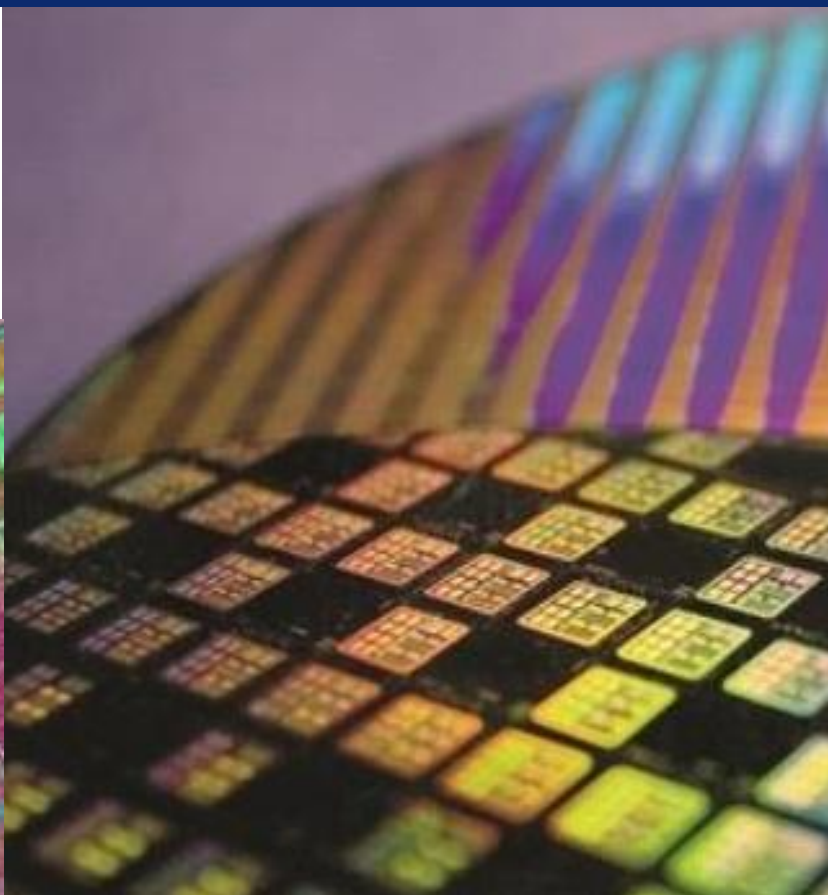
About OSE

晶片設計

MEDIATEK



誠正信實
INTEGRITY



晶片製造

TSMC

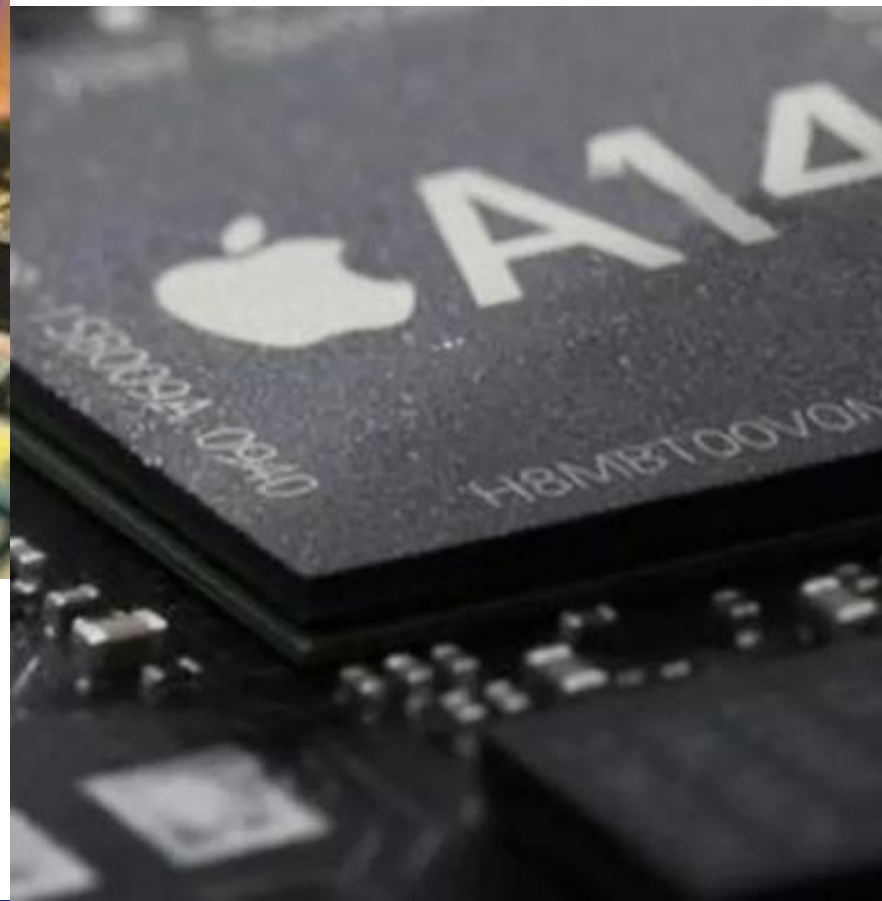
主動創新
INNOVATION

積極用心
PROACTIVENESS

封裝測試



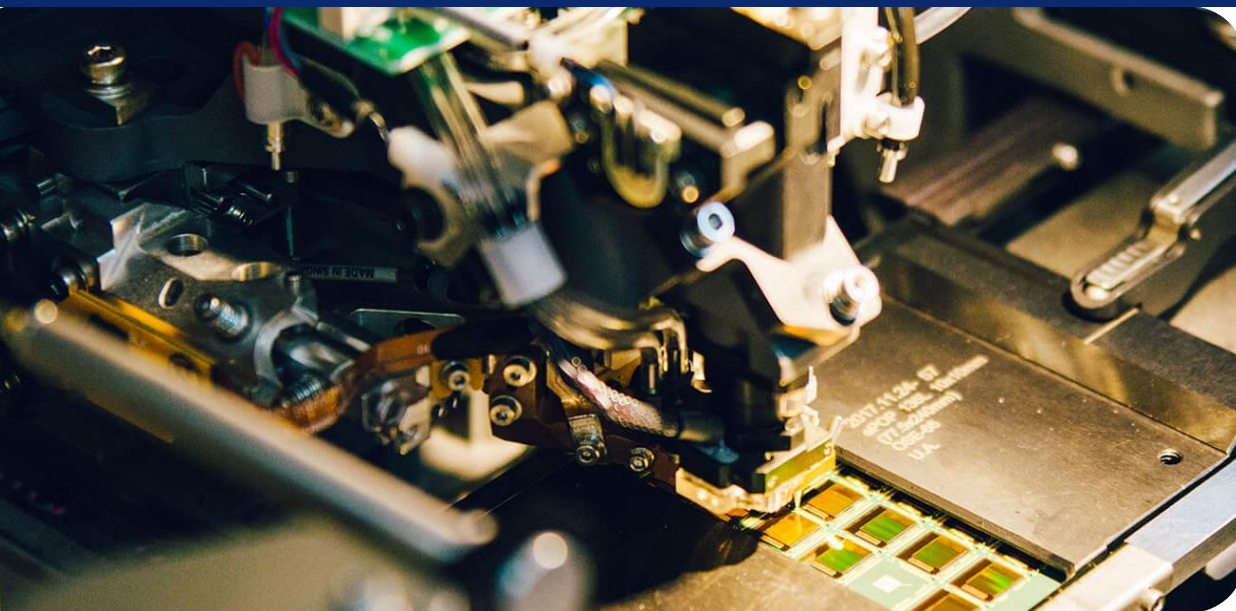
密
Security C



異體同心
EMPATHY

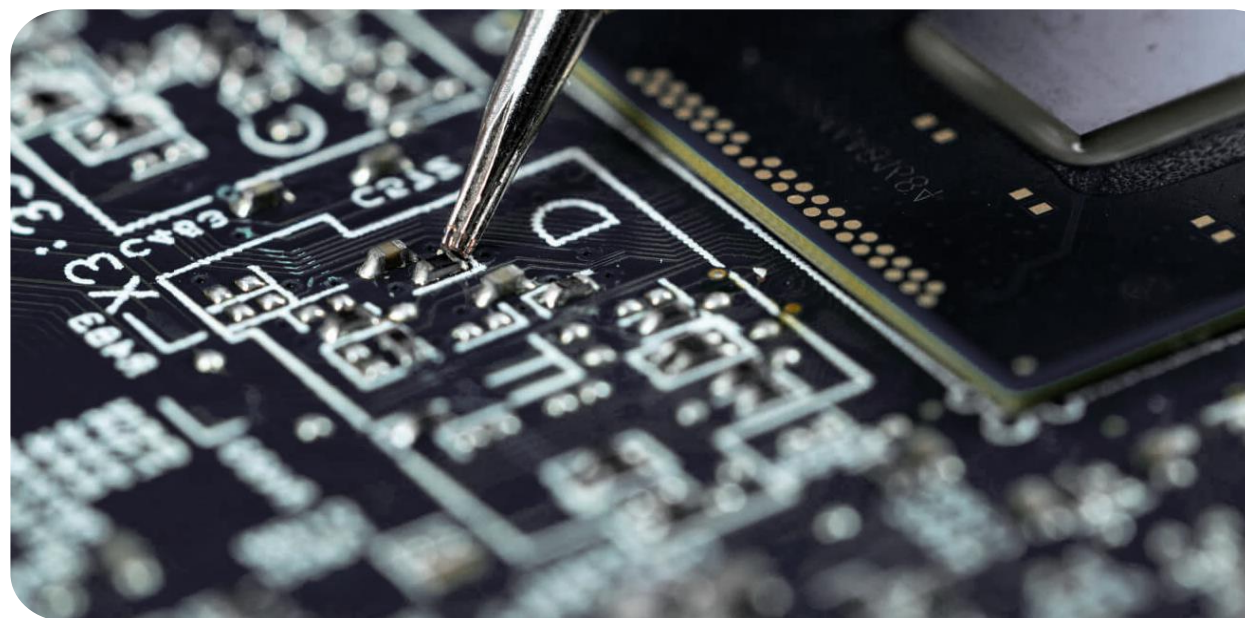


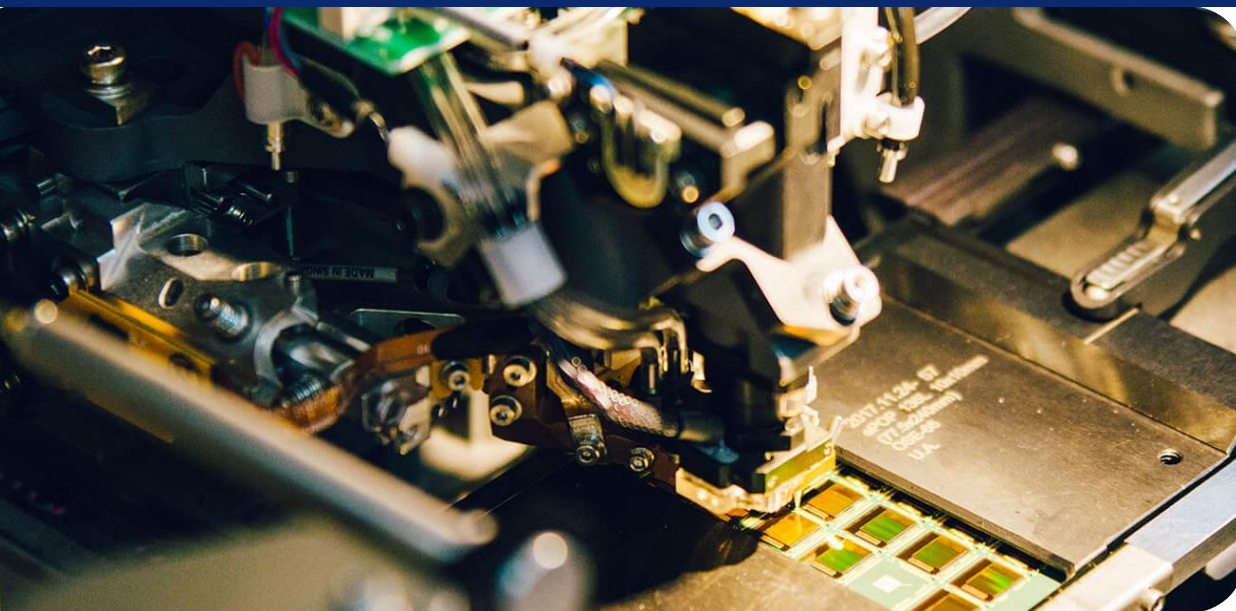
「幫晶片穿外衣、
做健康檢查」的專家



專業 電子代工 製造服務 2

1 積體電路 封裝與測試 製造服務

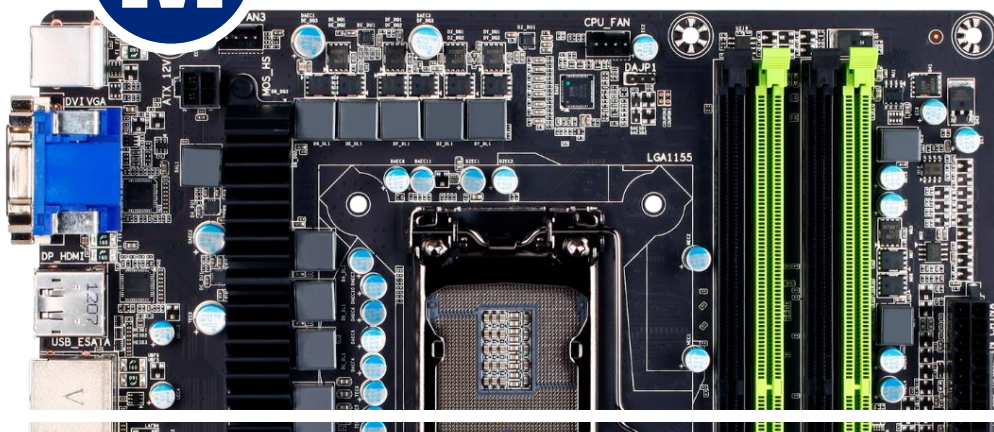




1 積體電路 封裝與測試 製造服務

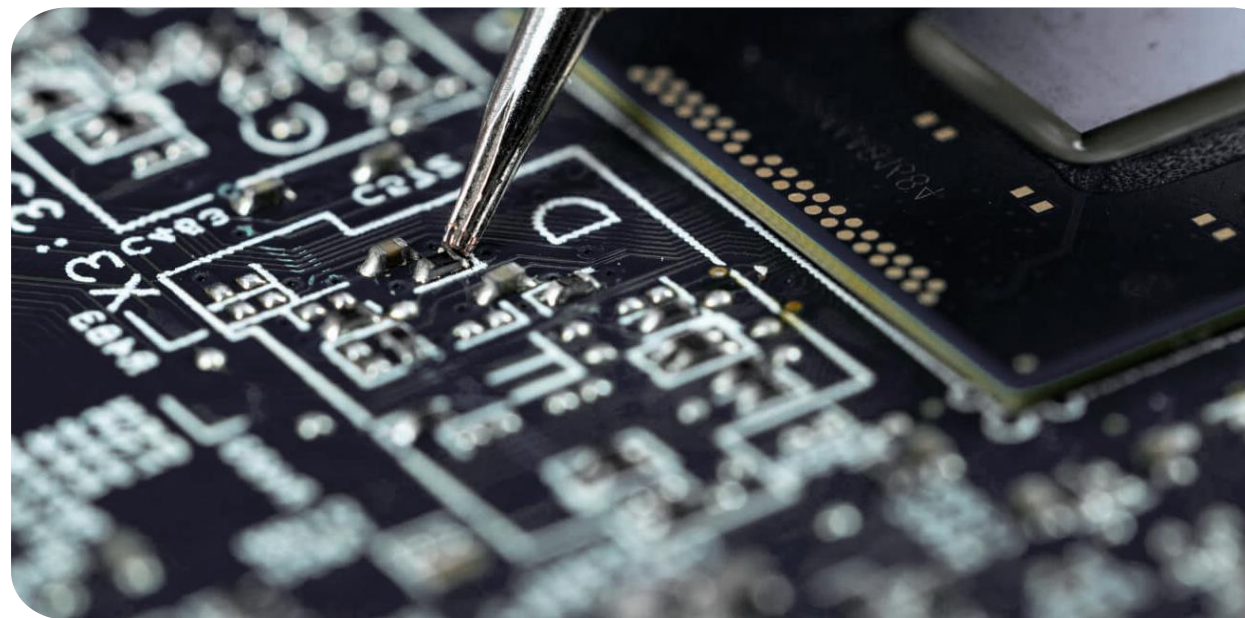


MOD BOARD



專業 電子代工 製造服務 2

電腦 檢驗器 顯示卡



航太

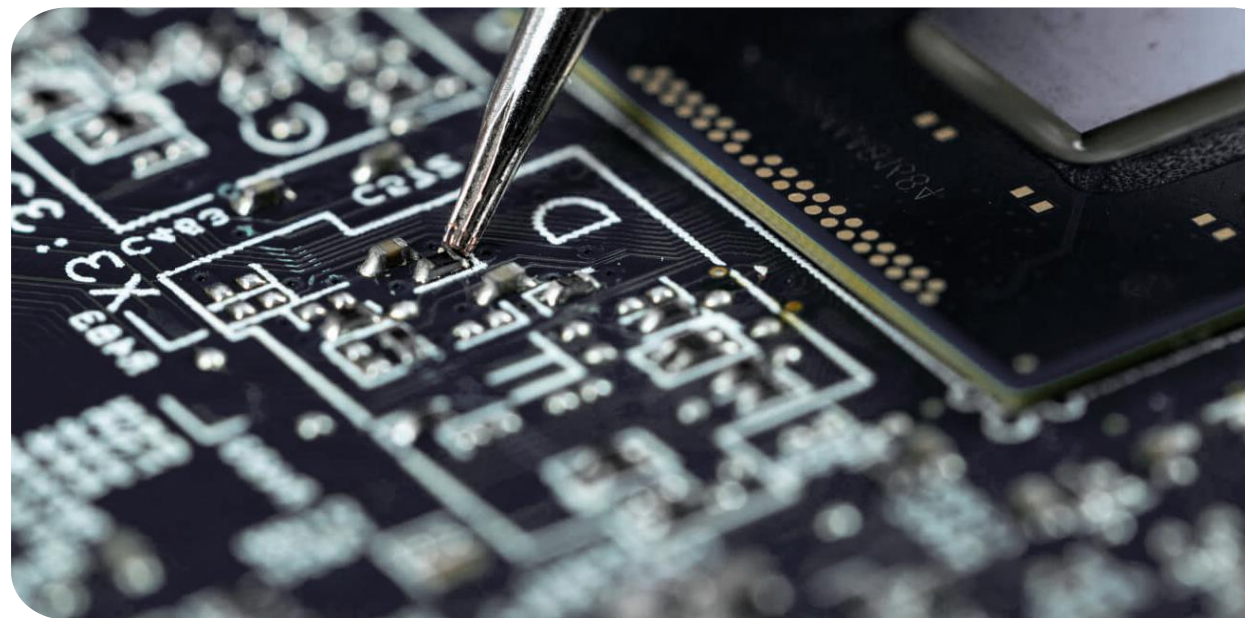
石油探勘

誠正信實
INTEGRITY

醫療

主動創新
INNOVATION

專業 電子代工 製造服務 2

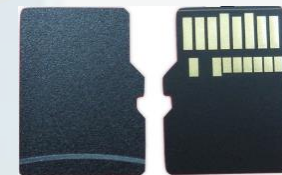


積極用心
PROACTIVENESS

異體同心
EMPATHY

2022

1st 封裝廠 :Wire Bond + Flip Chip microSD



2019

1st 1TB microSD



2015

IPA-A-610 Class 3 製程技術

2014

1st 封裝廠 : 16層Die堆疊



2010

13,000+ 電子零件/PCB

2006

1st 開發出「通用USB」尺寸



2000

1st Bluetooth SiP



記憶體 | 消費性電子 | 車載應用 | 工業應用 | 通訊應用 | 航太衛星

Leadframe

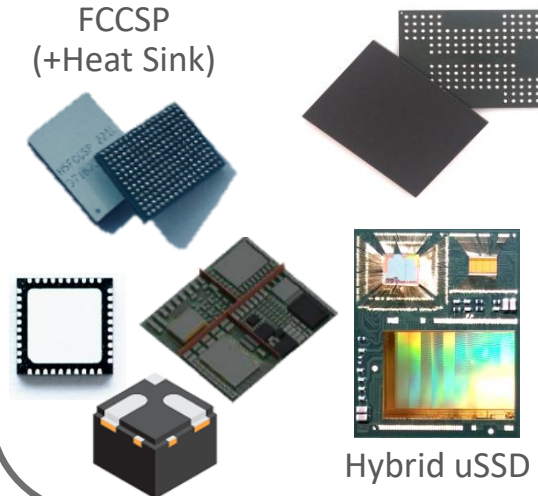


Flash Memory Card

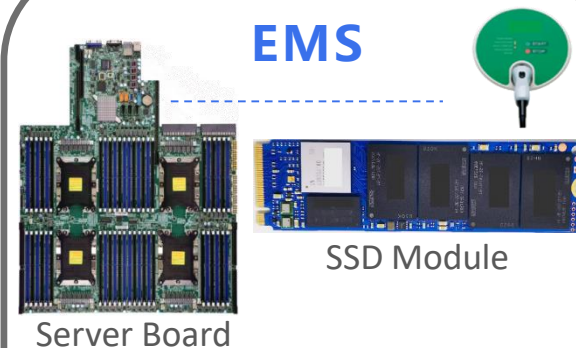


BGA (Flip Chip/Wire Bond/Hybrid)

FCCSP
(+Heat Sink)



EMS



獵風者衛星
發射升空



*Includes Wire Bond Type, Flip Chip Type, SiP, etc

16 / 42



HQ 總部

EMS 二廠

IC **FMC**

EMS 一廠

AT **IC**封測大樓

LIC **TEST**

IC **Fab1 x SP**

IC **Fab2** **EMS** 三廠

IC **Fab3** **EMS** 五廠



HQ 總部

EMS 二廠

IC FMC



AT IC封測大樓

LIC **TEST**



IC Fab1 x SP



IC Fab2 **EMS** 三廠



EMS 一廠



IC Fab3 **EMS** 五廠

誠正信實 INTEGRITY

誠心待人
處事公正
相互信任
腳踏實地

主動創新 INNOVATION

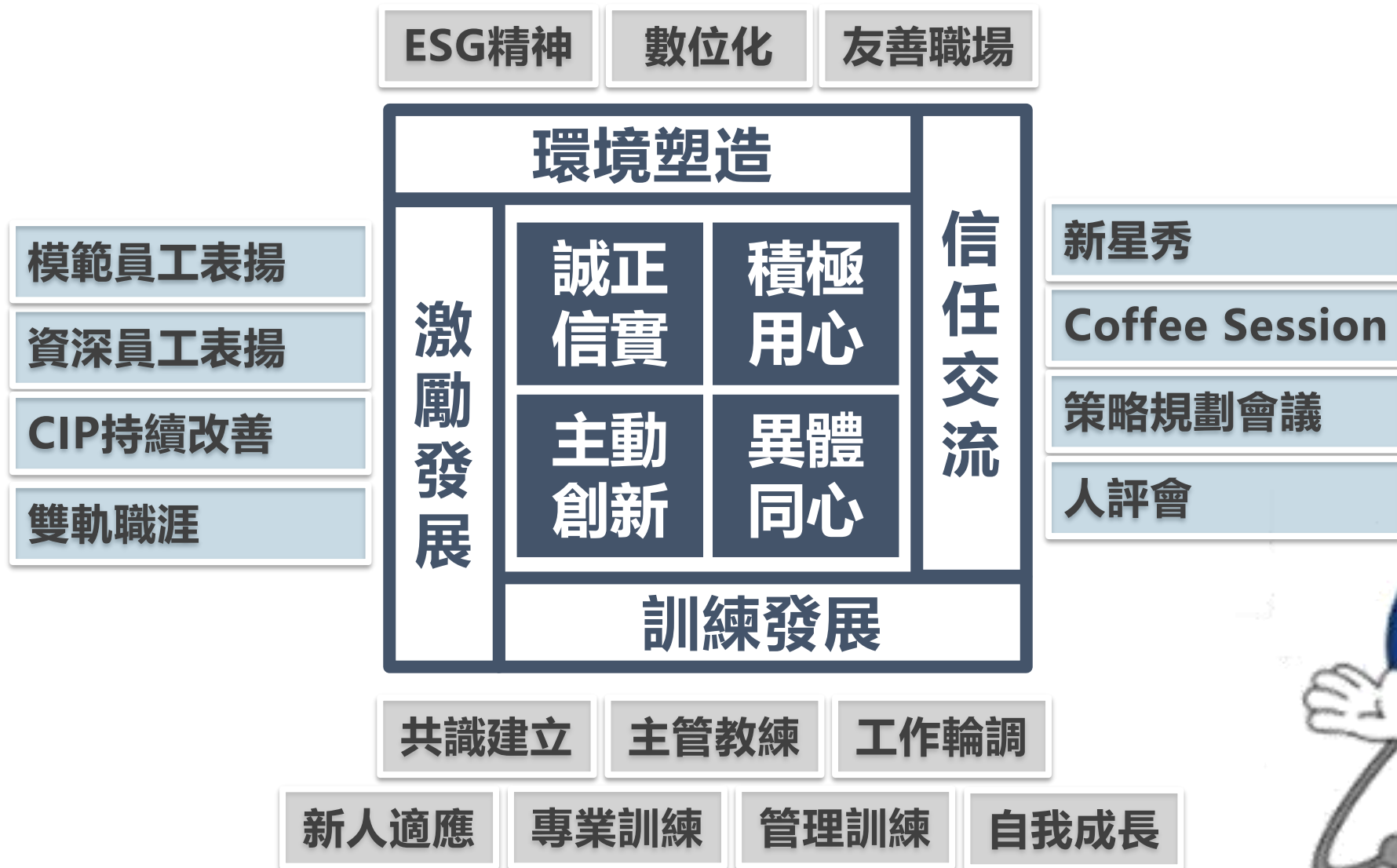
主動解決
持續改善
創新思維
開放態度

積極用心 PROACTIVENESS

工作熱忱
正向思考
認真盡責
超乎期待

異體同心 EMPATHY

樂於分享
夥伴關係
團隊合作
協同溝通





重視員工體驗

融入ESG精神

循環
共生

共融
成長



2023 OSE
植樹節活動
苗栽認養活動

活動內容

OSE準備了350棵可愛小樹苗，請攜帶3張1-3月發票登記領取，一起成為樹學家，透過各位的細心灌溉，為小樹苗營造一個美好的樹學「家」。

登記時間： 2/13-2/24 (已額滿)
領取時間： 3/10 (五)
領取地點： 各廠區警衛台 (請參照內部公告資訊)
領取時段： 早：7:30-9:00 午：17:00-18:00 晚：19:30-20:30



誠正信實
INTEGRITY



主動創新
INNOVATION



積極用心
PROACTIVENESS



異體同心
EMPATHY

華泰半導體封測學程

華泰封測學程 科目總覽

必修(7選4)	核心選修(8選4)	專業選修(8選3)
半導體元件物理	積體電路設計	半導體元件設計與模擬
半導體製程	材料科學	可靠度工程分析
電路學	儀器分析	應力分析
材料分析與檢測	材料表面工程/表面分析技術	智慧製造技術
半導體製程設備與技術	電機機械	量測原理
機器人與自動化應用	機電整合與自動化應用	機器學習/深度學習
實驗設計與統計應用	感測技術基礎科學	電子封裝技術
	材料力學	積體電路封裝測試

半導體學程

最低須修畢**11門**科目

- 含必修至少**4門**
- 必選修至少**4門**
- 選修至少**3門**以上，且**必修可抵選修**。

微學程

最低須修畢3門科目，必修/必選/選修各1門。

半導體學程 華泰禮包

保證面試

取得學程修畢證書，
保證面試。

到職獎金

收到華泰正式職缺聘書者，
提供到職獎勵金。

報名表單



THANK YOU

Q & A

QUESTION AND ANSWER



華泰電子 股份有限公司

Orient Semiconductor Electronics, Ltd.

誠正信實
INTEGRITY

主動創新
INNOVATION

積極用心
PROACTIVENESS

異體同心
EMPATHY